

リフィル式 ABS フィラメント利用ガイド

ご購入頂きましたリフィル式フィラメントの使用方法が変更となりました。
初回造形時に、スライサーソフト XYZprint 上で造形プロファイルの設定が必要になります。

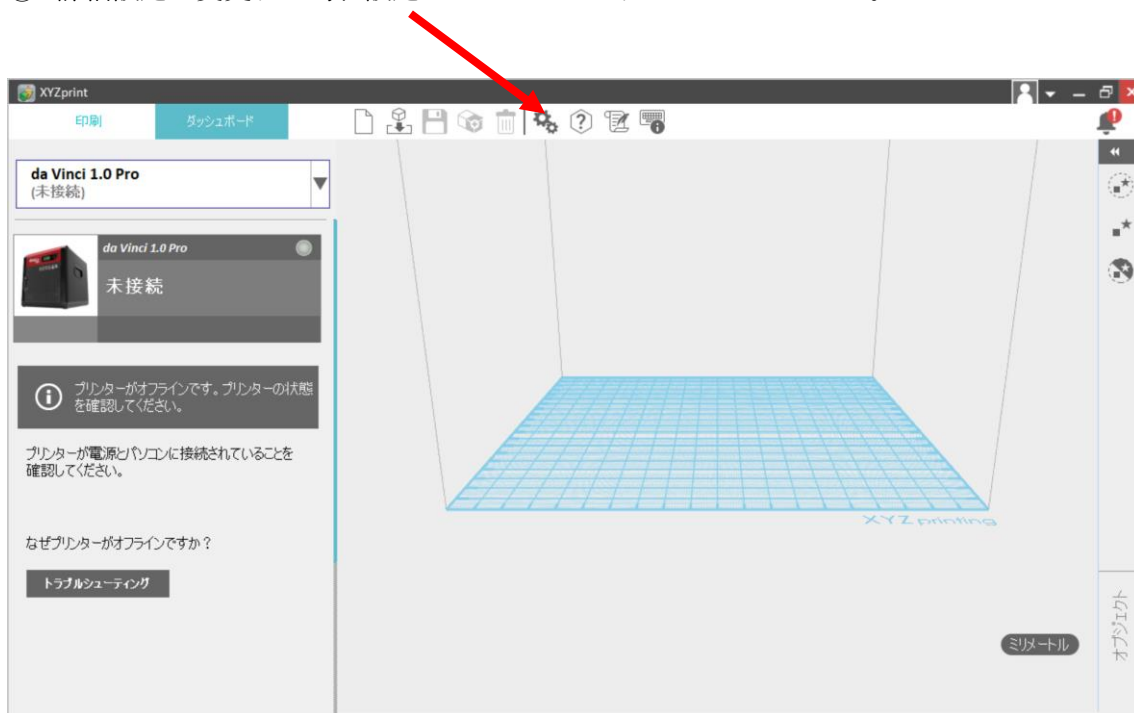
以下にご案内する手順で造形プロファイルを設定頂きますようお願い致します。

設定方法でご不明な点がありましたら、下記サイトまでお問い合わせください。

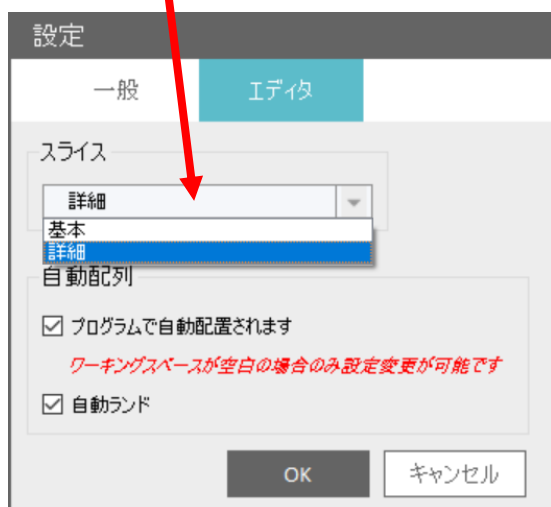
【ご購入後の製品に関するお問い合わせ】

https://krs.bz/iguazu/m/inq_after_xyz

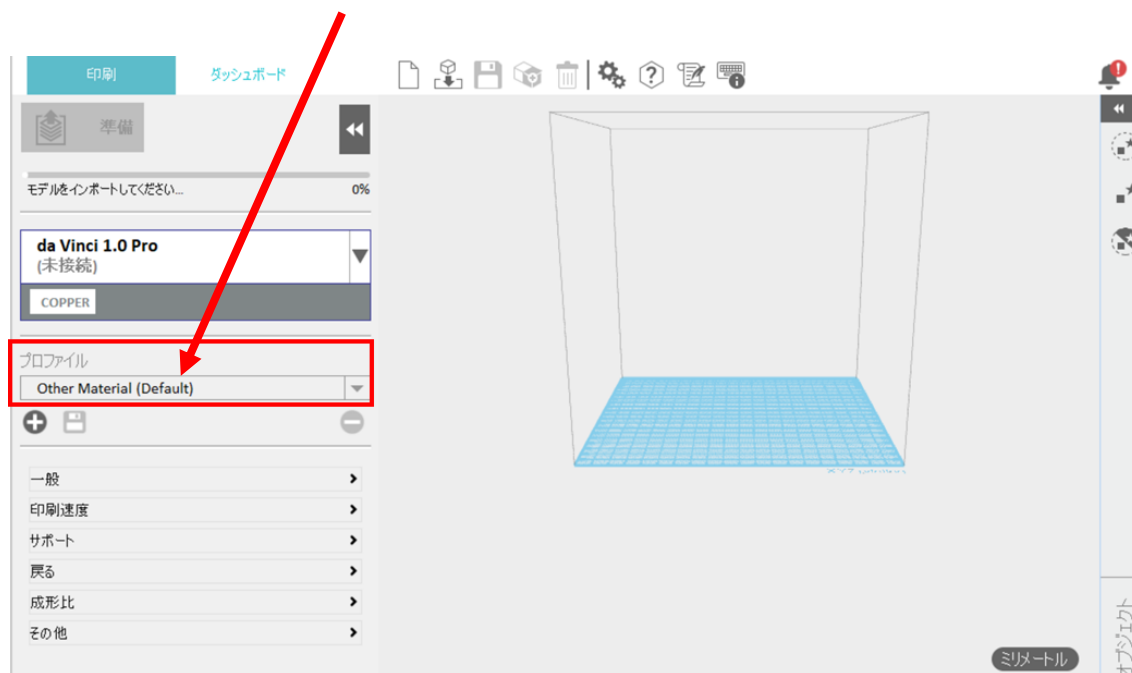
- ① 詳細設定に変更する為、設定のアイコンをクリックしてください。



エディタの詳細に設定してOKをクリックしてください。



② Other Material(Default)を選択してください。



③ 6～7 ページに記載致します造形プロファイルの情報を入力してください。

ここでは例として一般の造形プロファイルを確認してみます。

6～7 ページに記載致します造形プロファイルの各項目の設定情報を赤枠の入力画面に入力してください。

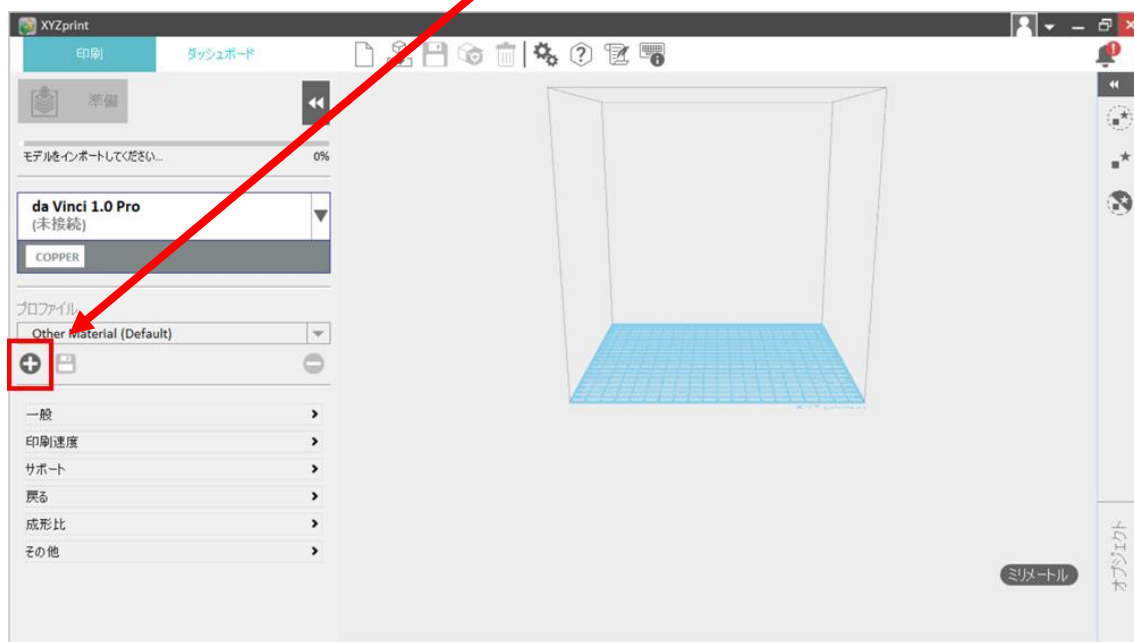
ノズル温度	210	°C
一層目印刷時のノズル温度	210	°C
プラットフォーム温度	90	°C
最初のレイヤーのプラットフォーム温度	90	°C
指定のレイヤーにプラットフォーム温度を変更するように設定する	2	layer
軽量化印刷を有効にする	OFF	
内部充填密度	10	%
インフィルタイプ	格子	
インフィル重ね率	25	%
インフィル重ね	0.100	mm
ダイナミックレイヤーの高さ		
レイヤーの高さ	0.20	mm
一層目レイヤーの高さ	0.35	mm
シェルの厚さ 普通	2	layer
シェルの厚さ 頂部表面	3	
シェルの厚さ 底部表面	3	
詳細しきい値	0.010	mm
ブリッジ抽出	OFF	
ブリッジ抽出比	90	%
充填物線の幅	0.40	mm
シェル線の幅	0.35	mm
トップ/ボトム線の幅	0.35	mm
開始レイヤー線の幅比率	120	%
印刷シーケンス	内部充填よりシェルを優先に印刷する	



ノズル温度	210	°C
一層目印刷時のノズル温度	210	°C
プラットフォーム温度	90	°C
最初のレイヤーのプラットフォーム温度	90	°C
指定のレイヤーにプラットフォーム温度を変更するように設定する	2	layer
軽量化印刷を有効にする	OFF	
内部充填密度	10	%
インフィルタイプ	格子	
インフィル重ね率	25	%
インフィル重ね		

この手順で印刷速度、サポート、戻る、成型比、その他の造形プロファイルを入力してください。

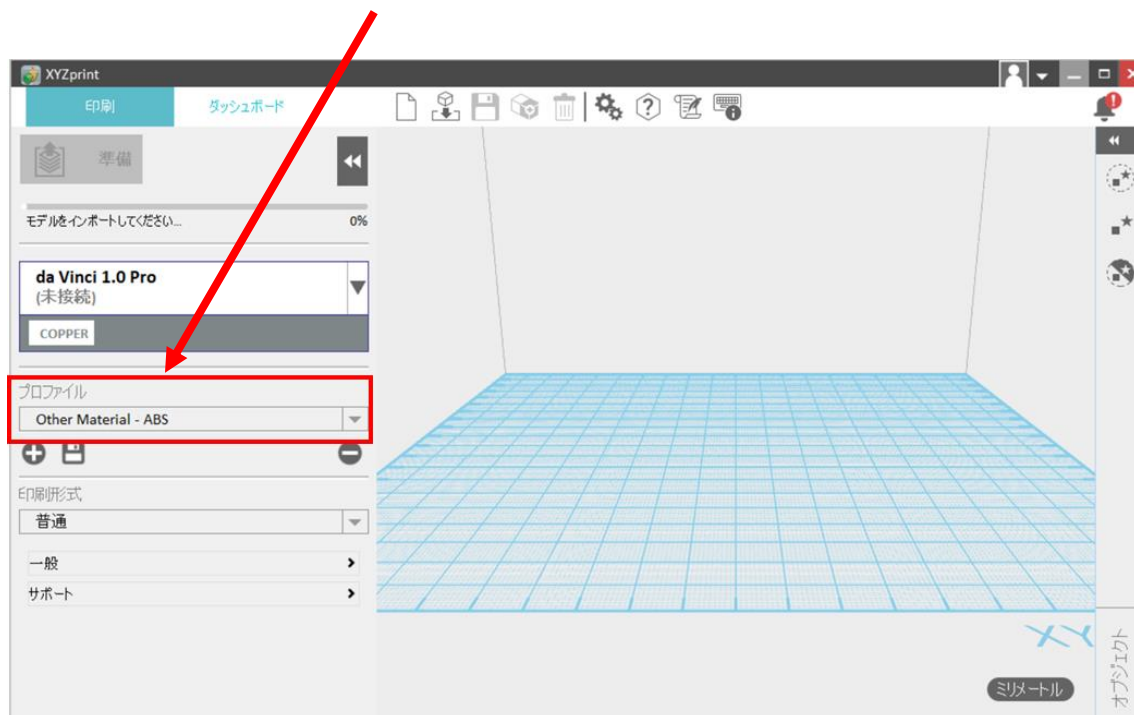
④ 全ての造形プロファイルの入力が終了した後、+ボタンをクリックしてください。



⑤ 任意のプロファイルの名前を入力してから保存してください。



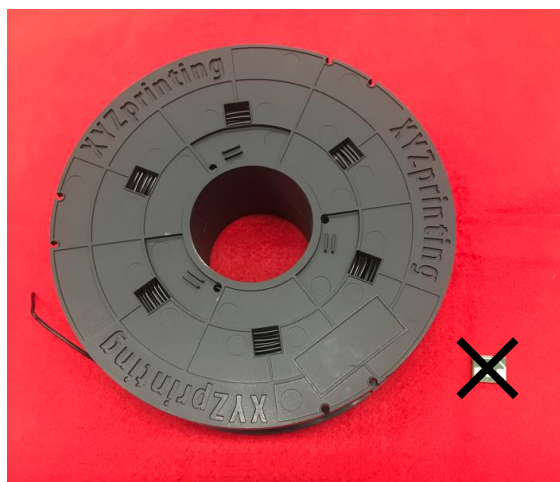
⑥ 次回以降は保存したプロファイルを選択してください。



■その他注意事項■

従来 XYZ プリンティング社より供給されておりました製品からの主な変更点は IC チップが無くなることとなります。これにより、以下の点にご注意頂きますよう、お願いいたします。

- ① チップは付けずにカートリッジにセットしてください。
(使用済み、使用中のフィラメントからのチップ流用は行わないでください。誤検知や入れ子状態による印刷設定の相違等、不具合の原因となる恐れがあります。)



- ② ご購入いただいたリフィル式フィラメントを使用する際、3Dプリンター上で材料の残量検知ができません。
- ③ PCと3DプリンターをUSBケーブルで接続してご利用の場合でも、ソフトウェア上でフィラメントを自動認識できません。このため、スライスデータ作成時にはプロファイル上に表示されておりますフィラメントの種類と3Dプリンターに取り付けられておりますフィラメントが合致していることをご確認いただく必要がございます。

ABS の造形プロファイル

一般

ノズル温度	210 °C
一層目印刷時のノズル温度	210 °C
プラットフォーム温度	90 °C
最初のレイヤーのプラットフォーム温度	90 °C
指定のレイヤーにプラットフォーム温度を変更するように設定する	2 layer
軽量化印刷を有効にする	OFF
内部充填密度	10 %
インフィルタイプ	格子
インフィル重ね率	25 %
インフィル重ね	0.100 mm
ダイナミックレイヤーの高さ	OFF
レイヤの高さ	0.20 mm
一層目レイヤーの高さ	0.35 mm
シェルの厚さ 普通	2 layer
シェルの厚さ 頂部表面	3
シェルの厚さ 底部表面	3
詳細しきい値	0.010 mm
ブリッジ検出	OFF
ブリッジ押出比	90 %
充填物線の幅	0.40 mm
シェル線の幅	0.35 mm
トップ/ボトム幅	0.35 mm
開始レイヤー線の幅比率	120 %
印刷シーケンス	内部充填よりシェルを優先に印刷する

印刷速度

シェル普通印刷速度	30 mm/s
シェル表層部印刷速度	30 mm/s
シェル小面表面印刷速度	30 mm/s
インフィル一般印刷速度	30 mm/s
インフィル頂部表面印刷速度	30 mm/s
内厚充填部分印刷速度	30 mm/s
ブリッジ印刷速度	20 mm/s
非印刷時の移動速度	45 mm/s
底部レイヤ速度	20 mm/s
細かな部分の自動スピード調整	OFF

ON のイメージ



OFF のイメージ



サポート

サポートを有効にする	OFF	
サポートベース	OFF	
サポート構造タイプ	格子	
サポートの密度	20	%
サポート速度	30	mm/s
サポート生成基準	45	°
サポート押し出し比率	100	%
サポート間隔	2	layer
サポート角度	90	°
サポートエリアの延伸	0	mm
ラフトを有効にする	OFF	
ラフトタイプ	格子	
ラフト密度	20	%
ラフト間隔	0.25	mm
ラフト押し出し比率	100	%
ラフトの拡張	5	mm
底辺を有効にする	OFF	
底辺の幅	10	mm

戻る

フィラメント吐き戻し速度	40	mm/s
引き戻しの後のロード速度	40	mm/s
引き戻しの長さ	6.0	mm
引き戻し機能有効値	2	mm
引き戻し作動時プラットフォームの下降値	0.0	mm
再起動による材料の補充	0.0	mm
レイヤーごとの引き戻しの実施	ON	
同一アウトライン印刷時の引き戻しなし	ON	

成形比

シェル成形非	100	%
肉薄時の中身充填比率	100	%
インフィル成形比	100	%
充填物表面造形時の出力率	100	%
個体充填物の出力率	90	%

その他

エクストルーダー移動時に造形物の上を通過することを避ける	OFF	
接続角設定	スマート隠す	
Horizontal Inserts	0.00	mm